

82988-1

737053

INTEL

# 微型计算机系列器件手册

上册

上海交通大学科技交流室  
微机研究室

一九八三年十二月

# 前 言

自1971年美国INTEL公司研制出单片的四位微处理器以来,已经有十多年的发展历程。随着大规模集成电路工艺的迅速发展,品种日趋增多,性能也日臻完善。因此,微型计算机不仅在各个领域获得了广泛应用,而且微处理器本身不断更新换代,目前已渗入到小型机的应用领域,并有大规模推广应用的趋势。

微型计算机之所以能如此迅速发展,并得到广泛应用,除价格低廉,性能日益提高外,还因为它具有体积小,灵活性大,适应性强等特点,因此值得重点介绍,并努力促进新产品新技术的开发和应用。

为早日实现四个现代化,使广大技术人员尽早地掌握和应用这一先进技术,我们翻译出版了1982年版本的INTEL系列器件手册。本手册既可供广大从事微型计算机开发、研制和应用的人员使用,也是高等院校、研究院所等单位师生和科技人员的参考工具书。

手册共十四章,分上、中、下册出版。第一章:随机存储器;第二章:只读存储器;第三章:磁泡;第四章:电话和信号处理;第五章:HMOS单片8位微计算机;第六章:MCS-48™系列单片微计算机;第七章:MCS-80/85™系列微计算机;第八章:iAPX 86,88系列微计算机;第九章:微计算机外围器件;第十章:iAPX432微主机系统;第十一章:工业级产品;第十二章:军级产品;第十三章:质量保证;第十四章:通用信息。其中第十一、十二章是INTEL系列的工业级系列和军级系列产品,除环境条件考核性能比民用产品优越外,逻辑功能和使用方法与民用系列产品完全相同。本书为减少篇幅,只列出了其中的产品目录。

参加本手册翻译工作的有上海交通大学计算中心杜毅仁,唐长钧,赵正校,陈永乐,谢康林,朱煜清,韩朔瞭,李世祥,杨辰圆,杨克忠,王洪澄,金树福,王明芳,夏雨仁,袁哲豫,徐子亮和广西南宁市电子学会张寿天,项湜伍,肖普隆,龙吉田,曹锦章,桂建安,张匡华,梁平,李包成,钟丽新,金字谱等同志。全书由杜毅仁,徐子亮,项湜伍同志审定。

由于我们水平有限,时间仓促,错误之处在所难免,谨请读者批评指正。

编 者

1983年10月

# 目 录

## 前言

<b>第一章 随机存贮器</b> .....	(1-1)
2114A 1024×4 位静态随机存贮器.....	(1-1)
2115A、2125A 系列高速 1K×1 位静态随机存贮器 .....	(1-5)
2115H、2125H 系列高速 1K×1 位静态随机存贮器 .....	(1-10)
2118 系列 16384×1 位动态存贮器 .....	(1-16)
2128 2048×8 位 静态随机存贮器 .....	(1-30)
2141 4096×1 位静态随机存贮器 .....	(1-34)
2142 1024×4 位静态随机存贮器 .....	(1-42)
2147A 高速 4096×1 位静态随机存贮器.....	(1-48)
2147H 高速 4096×1 位静态随机存贮器.....	(1-54)
2148H 1024×4 位静态随机存贮器 .....	(1-60)
2149H 1024×4 位静态随机存储器 .....	(1-65)
2164 系列 65,536×1 位动态随机存贮器 .....	(1-69)
2167 高速 16,384×1 位静态随机存贮器 .....	(1-80)
8148 4096×8 位集成随机存贮器 .....	(1-86)
2186/7 8192×8 位集成随机存贮器 .....	(1-88)
<b>第二章 只读存贮器</b> .....	(2-1)
2716 16K(2K×8)紫外线擦除 PROM .....	(2-1)
2732A 32K(4K×8)紫外线擦除PROM.....	(2-8)
2764 (8K×8)紫外线擦除PROM.....	(2-15)
27128 128K(16K×8)紫外线擦除PROM ..	(2-22)
2815 16K(2K×8)电擦除 PROM .....	(2-23)
2816 16K(2K×8)电擦除 PROM .....	(2-35)
2817 16K(2K×8)电擦除 PROM .....	(2-49)
3628A 8K(1K×8)双极型 PROM .....	(2-50)
3632 32K(4K×8)双极型 PROM .....	(2-53)
3636B 16K(2K×8)双极型 PROM.....	(3-56)
82S181/82HS181 8K(1K×8)双极型PROM.....	(2-59)
82S191/82HS191 16K(2K×8)双极型PROM .....	(2-62)
82S321/82HS321 32K(4K×8)双极型PROM .....	(2-65)
<b>第三章 磁泡</b> .....	(3-1)
BPK70 1M 位磁泡存贮器子系统 .....	(3-1)
BPK72 磁泡存贮器样机套件 .....	(3-3)

7110 1M 位磁泡存贮器 .....	(3-5)
7220-1 磁泡存贮器的控制器 .....	(3-13)
7230 磁泡存贮器用电流脉冲发生器 .....	(3-31)
7242 磁泡存贮器用的二元格式器/检测放大器 .....	(3-36)
7250 磁泡存贮器用线圈前置驱动器 .....	(3-48)
7254 磁泡存贮器用四芯 VMOS 驱动晶体管 .....	(3-52)
<b>第四章 电话和信号处理</b> .....	(4-1)
2910A PCM 编码/解码器— $\mu$ 原则, 8 位 A/D 和 D/A 组合变换器 .....	(4-1)
2911A PCM 编码/解码器—A 原则, 8 位 A/D 和 D/A 组合变换器 .....	(4-19)
2912A PCM 发送/接收滤波器 .....	(4-35)
2913/2914 组合单芯片 PCM 编码/解码器和滤波器 .....	(4-48)
2920/2921 信号处理器 .....	(4-66)
<b>第五章 HMOS 单片八位微计算机</b> .....	(5-1)
P80A49H/P80A39HL HMOS 单片 8 位微计算机 .....	(5-1)
P80A48L HMOS 单片 8 位微计算机组件 .....	(5-11)
P80A48H/P80A35HL HMOS 单片 8 位微计算机 .....	(5-21)
<b>第六章 MCS-48<sup>TM</sup> 系列单片微计算机</b> .....	(6-1)
8020H HMOS 单片 8 位微计算机 .....	(6-1)
8021 单片 8 位微计算机 .....	(6-9)
8021H HMOS 单片 8 位微计算机 .....	(6-10)
8022 带有 A/D 转换器的单片 8 位微计算机 .....	(6-21)
8022H 带有 A/D 转换器的高性能单片 8 位微计算机 .....	(6-29)
8031/8051/8751 单片 8 位微计算机 .....	(6-31)
8048H/8048H-1/8035HL/8035HL-1 HMOS 单片 8 位微计算机 .....	(6-50)
80C48/80C35 CHMOS 单片 8 位微计算机 .....	(6-60)
8748H/8035H HMOS 单片 EPROM 微计算机 .....	(6-68)
8049H/8039HL HMOS 单片 8 位微计算机 .....	(6-78)
80C49/80C39 CHMOS 单片 8 位微计算机 .....	(6-86)
8749H/8749H-8/8039H/8039H-8 HMOS 单片 EPROM 微计算机 .....	(6-94)
8243 MCS-48 <sup>R</sup> 输入/输出扩展器 .....	(6-105)
8050H/8040H HMOS 单片 8 位微计算机 .....	(6-111)

# 第一章 随机存贮器

## 2114A

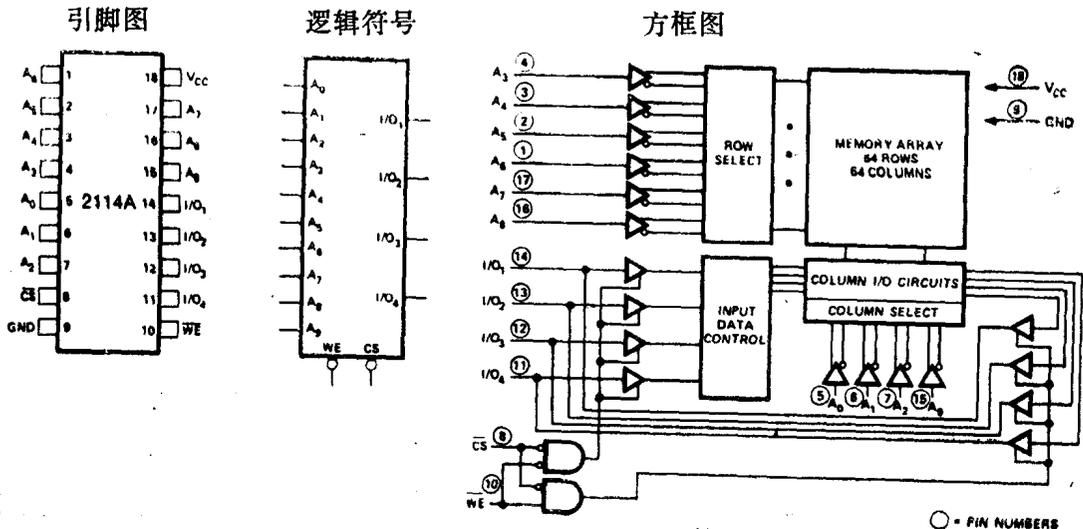
### 1024 × 4 位静态随机存贮器 (SRAM)

	2114AL-1	2114AL-2	2114AL-3	2114AL-4	2114AL-4	2114AL-5
最大存取时间(ns)	100	120	150	200	200	250
最大电流(mA)	40	40	40	40	70	70

- HMOS 工艺
- 全静态存贮器，不需要时钟或定时选通脉冲
- 低功耗，高速度
- 所有输入输出端都与 TTL 兼容
- 工作周期和存取时间相同
- 单电源 +5V ± 10% 容差
- 使用三态输出，数据的输入输出端共用
- 高密度、18 条引脚封装
- 2114 的升级产品

Intel 2114A 是一种 4096 位静态随机存贮器，结构为 1024 × 4 位，采用高性能的 HMOS 工艺。存贮器阵列和译码电路均采用全直流静态电路，因而无时钟或刷新的要求。由于几乎不需要地址建立时间，因而数据存取就特别简单。数据采取非破坏性读出，而且与输入极性相同。输入输出都是共用一个引脚。

2114A 是采用高性能和高可靠性的 HMOS 工艺，低成本、存贮容量大、输入/输出接口简单，是它重要的设计目标。2114A 采用最高密度的 18 条引脚封装。



它在输入、输出，以及单+5V电源等方面均直接与TTL兼容。当很多2114的输出端是“或”连接时，由选片(CS)很容易分别选择其中的某一片2114。

### 引脚名称

A <sub>0</sub> ~A <sub>9</sub> 地址输入	V <sub>CC</sub> 电源(+5V)
$\overline{WE}$ 允许写	GND 地
$\overline{CS}$ 片选	
I/O <sub>1</sub> ~I/O <sub>4</sub> 数据输入/输出	

### 极限参数\*

温度(加偏压).....	-10℃到+80℃
存放温度.....	-6.5℃到+150℃
任一引脚对地的电压.....	-3.5V到+7V
功耗.....	1.0W
直流输出电流.....	5mA

\*注：超出“极限参数值”可能使器件永久性损坏。它们仅仅是一些提请注意的参数，但不允许实际去使用，因为长期工作在这种极限参数下会影响器件的可靠性。

### 直流参数和工作特性

(除另说明外 T<sub>A</sub>=0℃到70℃, V<sub>CC</sub>=5V±10%)

符 号	参 数	2114AL-1/L-2/L3/L-4		2114A-4/-5		单 位	条 件
		最小	典型 <sup>[1]</sup> 最大	最小	典型 <sup>[1]</sup> 最大		
I <sub>LI</sub>	输入负载电流 (全部输入脚)		10		10	μA	V <sub>IN</sub> =0 to 5.5V
I <sub>LO</sub>	I/O 漏电流		10		10	μA	$\overline{CS} = V_{IH}$ V <sub>I/O</sub> =GND to V <sub>CC</sub>
I <sub>CC</sub>	电源电流	25	40	50	70	mA	V <sub>CC</sub> =max, I <sub>I/O</sub> =0mA T <sub>A</sub> =0℃
V <sub>IL</sub>	输入低电平	-3.0	0.8	-3.0	0.8	V	
V <sub>IH</sub>	输入高电平	2.0	6.0	2.0	6.0	V	
I <sub>OL</sub>	输出低电流	2.1	9.0	2.1	9.0	mA	V <sub>OL</sub> =0.4V
I <sub>OH</sub>	输出高电流	-1.0	-2.5	-1.0	-2.5	mA	V <sub>OH</sub> =2.4V
I <sub>OS</sub> <sup>[2]</sup>	输出短路电流		40		40	mA	

注：1. 典型值是T<sub>A</sub>=25℃、V<sub>CC</sub>=5.0V时测得的。

2. 持续时间不超过30秒。

### 电容(T<sub>A</sub>=25℃, f=1.0MHz)

符 号	测 试	最 大 值	单 位	条 件
C <sub>I/O</sub>	输入/输出电容	5	pF	V <sub>I/O</sub> =0V
C <sub>IN</sub>	输入电容	5	pF	V <sub>IN</sub> =0V

注：这个参数是定期抽样，不是100%的测试。

## 交流测试条件

输入脉冲电平	0.8V 到 2.0V
输入脉冲前后沿	10ns
输入输出计时电平	1.5V
输出负载	1个TTL 门加 $C_L = 100pF$

## 交流特性

(除另作说明外  $T_A = 0^\circ C$  到  $70^\circ C$ ,  $V_{CC} = 5V \pm 10\%$ )

### 一, 读周期<sup>[1]</sup>

符号	参 数	2114AL-1		2114AL-2		2114AL-3		2114A-4/L-4		2114A-5		单位
		最小	最大	最大	最小	最小	最大	最小	最大	最小	最大	
$t_{RC}$	读周期时间	100		120		150		200		250		ns
$t_A$	存取时间	100		120		150		200		250		ns
$t_{CO}$	"片选"到输出有效	70		70		70		70		85		ns
$t_{CX}$	"片选"到输出激励	10		10		10		10		10		ns
$t_{OTD}$	取消"片选"到输出三态	30		35		40		50		60		ns
$t_{OHA}$	地址变化而输出保持	15		15		15		15		15		ns

### 二, 写周期<sup>[2]</sup>

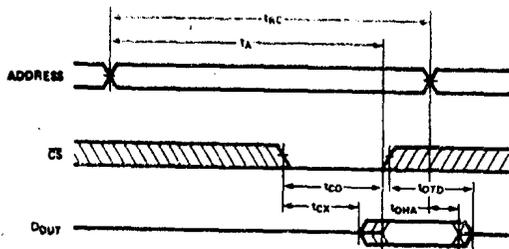
符号	参 数	2114AL-1		2114AL-2		2114AL-3		2114A-4/L-4		2114A-5		单位
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
$t_{WC}$	写周期时间	100		120		150		200		250		ns
$t_W$	写入时间	75		75		90		120		135		ns
$t_{WR}$	写释放时间	0		0		0		0		0		ns
$t_{OTW}$	从写开始到输出三态	30		35		40		50		60		ns
$t_{DW}$	写与数据的重叠时间	70		70		90		120		135		ns
$t_{DH}$	写入后到数据保持的时间	0		0		0		0		0		ns

注解: 1. 在  $\overline{CS}$  低电平与  $\overline{WE}$  高电平重叠期间发生读操作

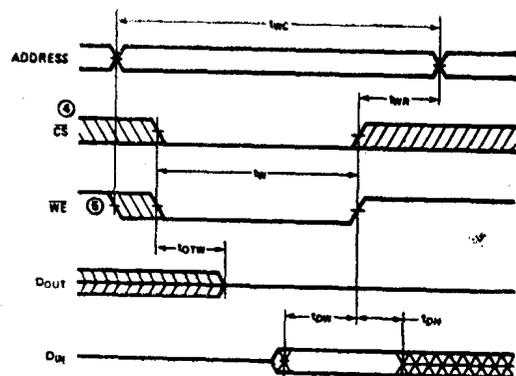
2. 在  $\overline{CS}$  低电平与  $\overline{WE}$  低电平重叠期间发生写操作。从  $\overline{CS}$ ,  $\overline{WE}$  中较后的一个由高电平变低电平的后沿到  $\overline{CS}$ ,  $\overline{WE}$  中较前的一个由低电平变高电平的前沿之间测量  $t_w$ 。

## 波形

### 读周期<sup>[3]</sup>



### 写周期



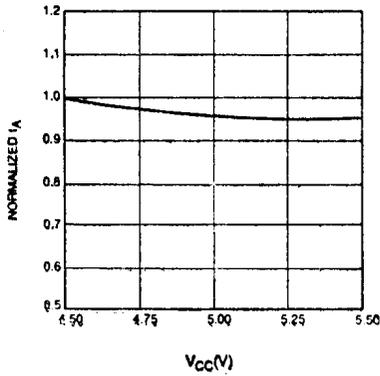
注解：3. 对读周期来说  $\overline{WE}$  为高电平。

4. 如果  $\overline{CS}$  变为低电平与  $\overline{WE}$  变为低电平同时发生，则输出缓冲器保持高阻抗状态。

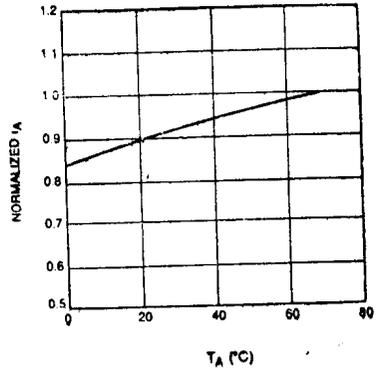
5. 在地址变化期间  $\overline{WE}$  必须为高电平

### 典型的直流和交流特性

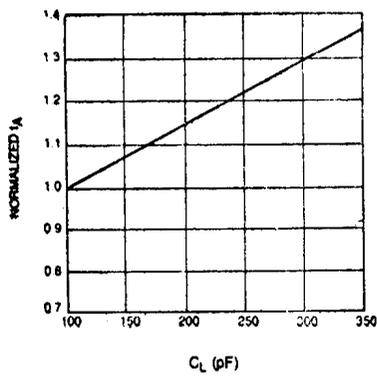
正常存取时间对电源电压的关系



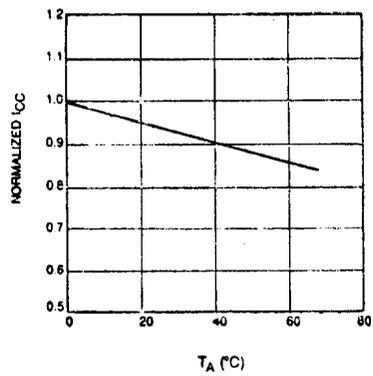
正常存取时间对环境温度的关系



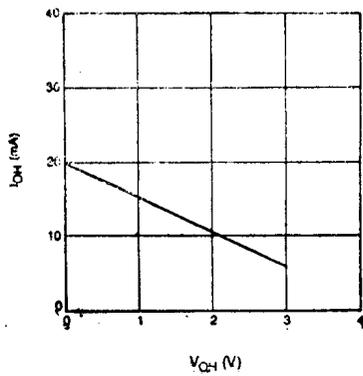
正常存取时间对输出负载电容的关系



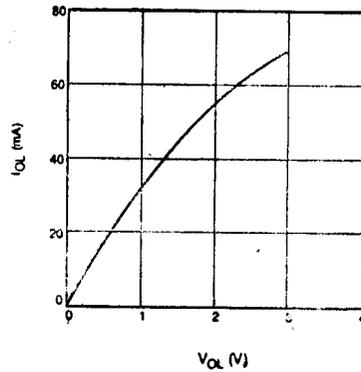
正常电源电流对环境温度的关系



输出电流与输出电压的关系



输出端吸收电流对输出电压关系



## 2115A、2125A 系列 高速 $1K \times 1$ 位静态随机存储器

	2115AL, 2125AL	2115A, 2125A	2115AL-2, 2125AL-2	2115A-2, 2125A-2
最大值 $T_{AA}(ns)$	45	45	70	70
最大值 $I_{cc}(mA)$	75	125	75	125

- 引脚与 93415A(2115A)及 93425A(2125A)兼容
- 输入和输出都是 TTL 电平
- 单电源 +5V
- 10 个 TTL 扇出负载(2115A 系列), 输出端吸收电流为 16mA。
- 集电极开路(2115A)和三态(2125A)输出
- 低运行功耗—最大为 0.39mw/位(2115AL, 2125AL)
- 标准 16 条引脚双列直插式封装

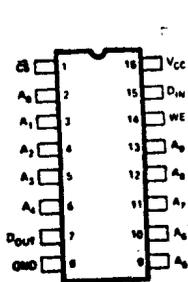
Intel 2115A 和 2125A 系列是  $1024 \times 1$  位的高速随机存储器。既可以集电极开路(2115A)也可以三态输出(2125A)。2115A 和 2125A 存储器阵列和译码均采用全直流静态电路。因而无时钟和刷新方面的要求。数据为非破坏性读出, 且与输入数据同极性。

最大存取时间为 45ns 的 2115AL/2125AL 及最大存取时间为 70ns 的 2115AL-2/2125AL-2 与双极型工业产品 RAM 是完全兼容的, 同时功率比双极型 RAM 要低 50%。2115AL/2125AL 及 2115AL-2/2125AL-2 的最大功耗是 394mw, 相当于最大功耗为 814mw 的双极型存储器。对于已经用 1K 双极型 RAM 设计的系统, 均可分别用最大存取时间为 45ns 的 2115A/2125A 及最大存取时间为 70ns 的 2115A-2/2125A-2 来代替, 并且其最大功耗还可以下降 20%。

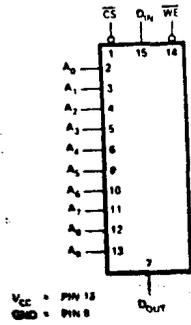
该器件在输入、输出以及单电源 +5V 等方面均直接与 TTL 兼容。当输出端有很多 2115A 或 2125A 并联使用时, 可由  $\overline{CS}$  片选端来分别选择其中某一片电路。

2115A 和 2125A 系列是用 Intel 的 N 沟硅栅工艺制造的。

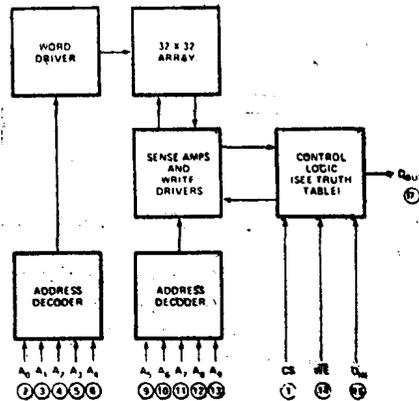
引脚图



逻辑符号



框图



引脚名称

CS	片选
A <sub>0</sub> ~A <sub>9</sub>	地址输入
WE	允许写
D <sub>IN</sub>	数据输入
D <sub>OUT</sub>	数据输出

真值表

输入			输出端 2115A系列	输出端 2125A系列	状态
CS	WE	D <sub>IN</sub>	D <sub>OUT</sub>	D <sub>OUT</sub>	
H	X	X	H	HIGH Z	没选中
L	L	L	H	HIGH Z	写“0”
L	L	H	H	HIGH Z	写“1”
L	H	X	D <sub>OUT</sub>	D <sub>OUT</sub>	读

极限参数\*

温度(加偏压)..... -10℃到+85℃  
 存放温度..... -65℃到+150℃  
 所有输出端或电源..... -0.5V到+7V  
 所有输入电压..... -0.5V到+5.5V  
 直流输出电流..... 20mA

•注:超出“极限参数值”可能使永久性损坏。它们仅仅是一些提请注意的参数。但不允许实际去使用,因为长期工作在这种极限参数下会影响器件的可靠性。

直流特性<sup>[1,2]</sup>

V<sub>CC</sub> = 5V ± 5%, T<sub>A</sub> = 0℃到75℃

符号	测试	最小	典型	最大	单位	条件
V <sub>OL1</sub>	2115A系列输出低电平			0.45	V	I <sub>OL</sub> = 16mA
V <sub>OL2</sub>	2125A系列输出低电平			0.45	V	I <sub>OL</sub> = 7mA
V <sub>IH</sub>	输入高电平	2.1			V	
V <sub>IL</sub>	输入低电平			0.8	V	
I <sub>IL</sub>	输入低电流		-0.1	-40	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>IN</sub> = 0.4V
I <sub>IH</sub>	输入高电流		0.1	40	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>IN</sub> = 4.5V
I <sub>CEx</sub>	2115A系列输出漏电流		0.1	100	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>OUT</sub> = 4.5V
I <sub>OPF</sub>	2125系列输出电流(高Z)		0.1	50	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>OUT</sub> = 0.5V/2.4V
I <sub>OS</sub> [3]	2125A系列对地短路电流			-100	mA	V <sub>CC</sub> = Max
V <sub>OH</sub>	输出高电平	2.4			V	I <sub>OH</sub> = -3.2mA
I <sub>CC</sub>	电源电流 I <sub>CC1</sub> : 2115AL, 2115AL-2 2125AL, 2125AL-2		60	75	mA	所有输入接地, 输出开路
	I <sub>CC2</sub> : 2115A, 2115A-2 2125A, 2125A-2		100	125	mA	

注: 1. 工作时环境温度范围应保证横向空气流动超过400呎/分, 并在两分钟内启动。管壳最高值温度的典型热电阻值为:

$$\theta_{JA}(@400\text{fpm air flow}) = 45^\circ\text{C/W}$$

$$\theta_{JA}(\text{still air}) = 60^\circ\text{C/W}$$

$$\theta_{JC} = 25^\circ\text{C/W}$$

- 典型极限值是在V<sub>CC</sub> = 5V, T<sub>A</sub> = +25℃, 和最大负载时测得。
- 短路电流的持续时间不得超过1秒。

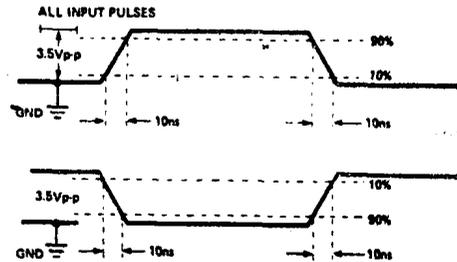
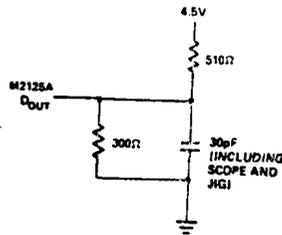
2115A 系列交流特性<sup>[1,2]</sup>  $V_{CC} = 5V \pm 5\%$ ,  $T_A = 0^\circ C$  到  $75^\circ C$   
 读周期

符号	测 试	2115AL Limits			2115A Limits			2115AL-2 Limits			2115A-2 Limits			Units
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
$t_{ACS}$	片选时间	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	40	ns
$t_{RCS}$	片选恢复时间		10	30		10	30		10	30		10	40	ns
$t_{AA}$	地址访问时间		30	45		30	45		40	70		40	70	ns
$t_{OH}$	地址变化以后 读出数据以前时间	10			10			10			10			ns

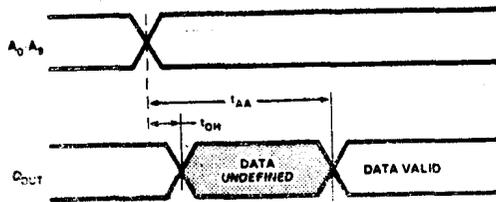
写周期

符号	测 试	Min. Typ. Max.			Units									
		Min.	Typ.	Max.										
$t_{WS}$	允许写入时间		10	25		10	30		10	25		10	40	
$t_{WR}$	写恢复时间	0		25	0		30	0		25	0		45	ns
$t_W$	写脉冲宽度	30	20		30	10		30	15		50	15		ns
$t_{WSD}$	数据建立时间到写	0	-5		5	-5		0	-5		5	-5		ns
$t_{WHD}$	写入后数据保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WSA}$	地址建立时间	5	0		5	0		5	0		15	0		ns
$t_{WHA}$	地址保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WSCS}$	片选建立时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WHCS}$	片选保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns

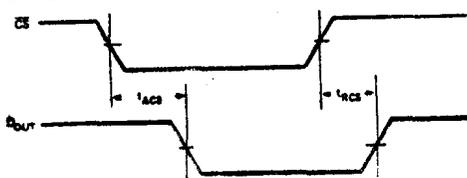
交流测试条件



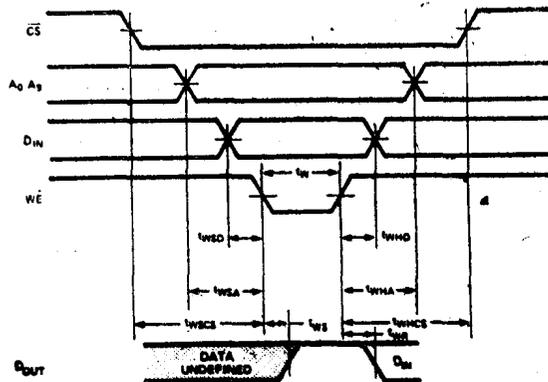
读周期



PROPAGATION DELAY FROM CHIP SELECT



写周期



上面所有的测量参考点为1.5V

### 2125 系列交流特性<sup>[1,2]</sup>

$V_{CC} = 5V \pm 5\%$ ,  $T_A = 0^\circ C$  到  $75^\circ C$

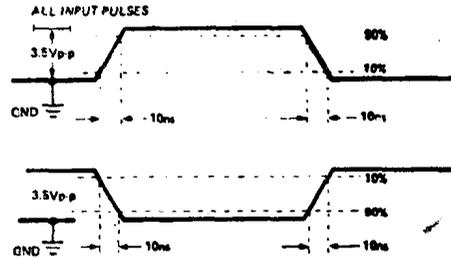
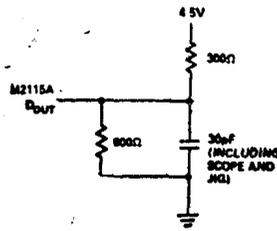
#### 读周期

符号	测 试	2125AL Limits			2125A Limits			2125AL-2 Limits			2125A-2 Limits			Units
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
$t_{ACS}$	片选时间	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	40	ns
$t_{ZRCS}$	片选到高阻抗		10	30		10	30		10	30		10	40	ns
$t_{AA}$	访问地址时间		30	45		30	45		40	70		40	70	ns
$t_{OH}$	地址变化以后读出数据以前时间	10			10			10			10			ns

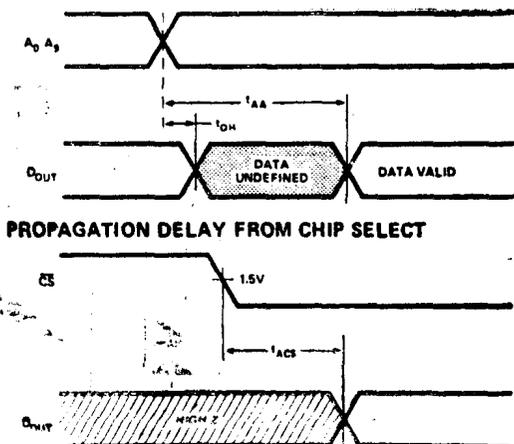
#### 写周期

符号	测 试	Min. Typ. Max.			Units									
		Min.	Typ.	Max.										
$t_{ZWS}$	允许写到高阻抗		10	25		10	30		10	25		10	40	ns
$t_{WR}$	写恢复时间	0		25	0		30	0		25	0		45	ns
$t_W$	写脉冲宽度	30	20		30	10		30	10		50	15		ns
$t_{WSD}$	数据建立到写	0	-5		5	-5		0	-5		5	-5		ns
$t_{WHD}$	写入后数据保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WSA}$	地址建立时间	5	0		5	0		5	0		15	0		ns
$t_{WHA}$	地址保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WSCS}$	片选建立时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WHCS}$	片选保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns

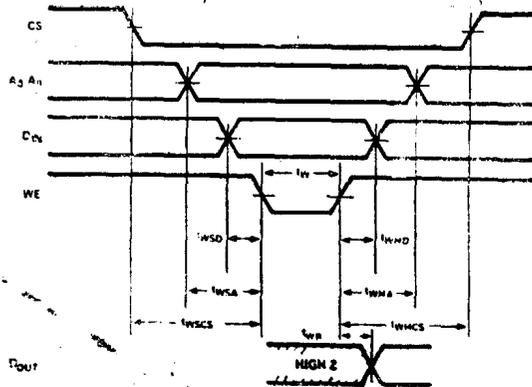
#### 交流测试条件



#### 读周期

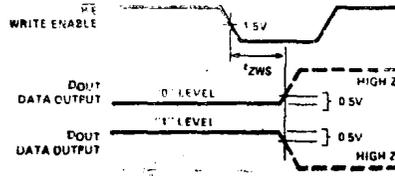
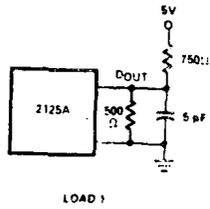


#### 写周期

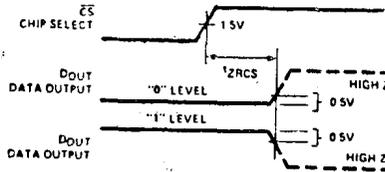


(以上所有测试参考点为1.5V)

## 2125 系列写启动到高阻抗的延时



## 2125 系列从片选到高阻抗的传输延时



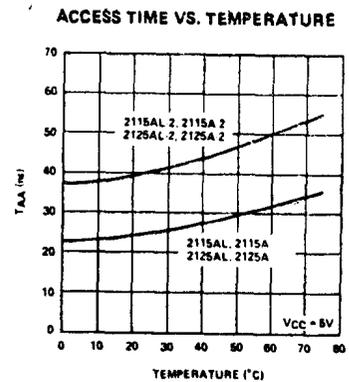
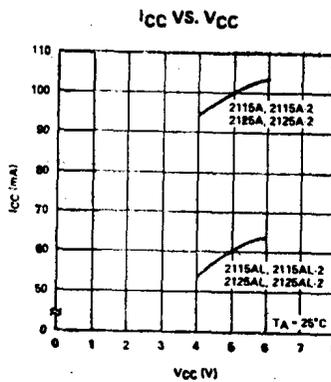
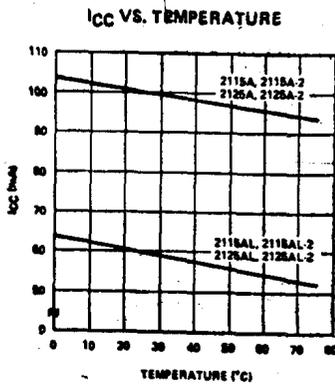
(ALL  $t_{ZXXX}$  PARAMETERS ARE MEASURED AT A DELTA OF 0.5V FROM THE LOGIC LEVEL AND USING LOAD 1)

2115A/2125A 系列电容\*  $V_{CC} = 5V, f = 1MHz, T_A = 25^\circ C$

SYMBOL	TEST	2115A Family LIMITS		2125A Family LIMITS		UNITS	TEST CONDITIONS
		TYP.	MAX.	TYP.	MAX.		
$C_i$	Input Capacitance	8	5	8	5	pF	All Inputs = 0V, Output Open
$C_o$	Output Capacitance	5	8	5	8	pF	$\overline{CS} = 5V$ , All Other Inputs = 0V, Output Open

\*此参数是定期抽样并不是100%的测试。

## 典型特性



## 2115H, 2125H 系列 高速 1KX1 位 静态随机存储器 (SRAM)

	2125H-1	2115H-2, 2125H-2	2115H-3, 2125H-3	2115H-4, 2125H-4
最大 $T_{AA}(ns)$	20	25	30	35
最大 $I_{cc}(mA)$	150	125	100	125

- HMOS I 工艺
- 所有输入输出端均与 TTL 兼容
- 引脚与 93415A(2115H) 和 93425A(2125H) 兼容
- 单电源 +5V
- 输出吸收电流为 16mA
- 集电极开路(2115H)和三态(2125H)输出
- 低运行功耗—最大为 0.53mW/位(2115H-3, 2125H-3)
- 标准 16 条引脚双列直插式封装

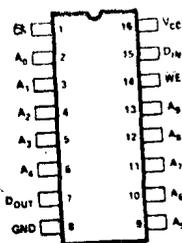
Intel 2115H 和 2125H 系列是  $1024 \times 1$  位的高速随机存取存储器，它是用 HMOS I 制造的 (Intel 公司先进 N 沟硅栅 MOS 工艺)。既可以集电极开路(2115H)也可以三态输出(2125H)。存储器阵列和译码电路均采用全直流静态电路，因而无时钟或刷新方面的要求。数据为非破坏性读出，且与输入数据同极性。

HMOS I 的先进工艺使 1K 静态 RAM 的工业产品达到非常高的速度 (存取时间只有 20ns)，而且功耗低。

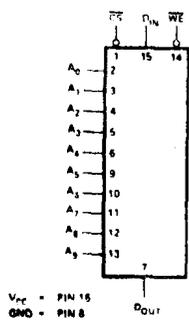
HMOS I 的 2115H/2125H 系列产品与 1K 双极型 RAM 完全兼容，而且功耗降低。最大功耗 525mw 和 656mw 与双极型 RAM 的 814mw 功耗相比分别降低了 19% 和 36%。

该器件在输入、输出以及单 +5V 电源等方面均直接与 TTL 兼容。当输出端有很多 2115H/2125H 并联时，选片 ( $\overline{CS}$ ) 很容易分别选择其中某一片 2115H/2125H。

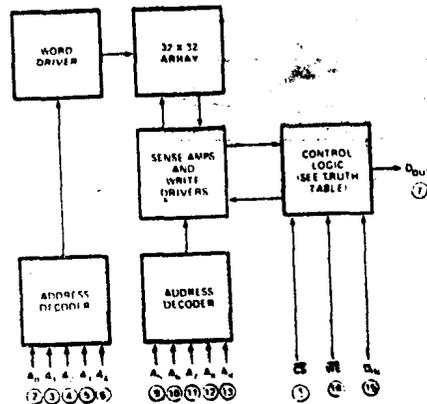
引脚图



逻辑符号



方框图



引脚名称

CS	片选
A <sub>0</sub> 到A <sub>9</sub>	输入地址
WE	允许写入
D <sub>IN</sub>	数据输入
D <sub>OUT</sub>	数据输出

真值表

INPUTS			OUTPUT 2115H FAMILY	OUTPUT 2125H FAMILY	MODE
CS	WE	D <sub>IN</sub>	D <sub>OUT</sub>	D <sub>OUT</sub>	
H	X	X	HIGH Z	HIGH Z	NOT SELETED
L	L	L	HIGH Z	HIGH Z	WRITE <sup>0</sup>
L	L	H	HIGH Z	HIGH Z	WRITE <sup>1</sup>
L	H	X	D <sub>OUT</sub>	D <sub>OUT</sub>	READ

极限参数\*

- 温度(加偏压).....-10℃到+85℃
- 存放温度.....-65℃到+150℃
- 所有输出或电源电压.....-0.5V到+7V
- 所有输入电压.....-1.5V到+7V
- 直流输出电流.....20mA

\*注 超出“极限参数”可能使器件永久性损坏，它们仅仅是一些提请注意的参数，但不允许实际去使用，因为长期工作在这种极限参数下会影响器件的可靠性

直流参数<sup>[1,2]</sup> V<sub>CC</sub> = 5V ± 5%, T<sub>A</sub> = 0℃到75℃

Symbol	Test	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
V <sub>OL</sub>	2115H/25H Family Output Low Voltage			0.45	V	I <sub>OL</sub> = 16mA
V <sub>IH</sub>	Input High Voltage	2.1			V	
V <sub>IL</sub>	Input Low Voltage			0.8	V	
I <sub>IL</sub>	Input Low Current		-0.1	-40	μA	V <sub>CC</sub> = Max., V <sub>IN</sub> = 0.4V
I <sub>IH</sub>	Input High Current		0.1	40	μA	V <sub>CC</sub> = Max., V <sub>IN</sub> = 4.5V
I <sub>CEx</sub>	2115H Family Output Leakage Current		0.1	100	μA	V <sub>CC</sub> = Max., V <sub>OUT</sub> = 4.5V
I <sub>OFF</sub>	2125H Family Output Current (High Z)		0.1	50	μA	V <sub>CC</sub> = Max., V <sub>OUT</sub> = 0.5V/2.4V
I <sub>OS</sub>	2125H Family Current Short Circuit to Ground		125	200	mA	V <sub>CC</sub> = Max.
V <sub>OH</sub>	Family Output High Voltage	2.4			V	I <sub>OH</sub> = -5.2mA
I <sub>CC</sub>	Power Supply Current: I <sub>CC1</sub> : 2125H-1		80	150	mA	All Inputs Grounded, Output Open
	I <sub>CC2</sub> : 2115H-2/2125H-2 2115H-4/2125H-4		80	125	mA	
	I <sub>CC3</sub> : 2115H-3/2125H-3		80	100	mA	

注: 1. 工作时环境温度范围保证横向空气流动, 每分钟超过400呎/分。

2. 典型极限是V<sub>CC</sub> = 5V, T<sub>A</sub> = +25℃, 是最大负载。

2115H 系列交流特性  $V_{CC} = 5V \pm 5\%$ ,  $T_A = 0^\circ C$  到  $75^\circ C$

读周期

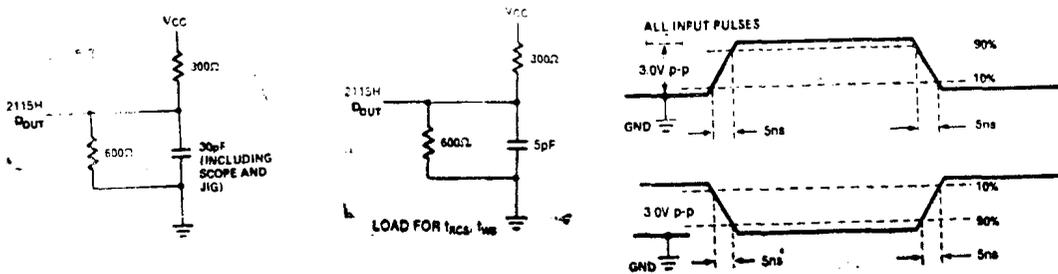
Symbol	Test	2115H-2 Limits		2115H-3 Limits		2115H-4 Limits		Units
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
$t_{ACS}$	Chip Select Time		15		20		20	ns
$t_{RCS}$ [1]	Chip Select Recovery Time		20		20		20	ns
$t_{AA}$	Address Access Time		25		30		35	ns
$t_{OH}$ [1]	Previous Read Data valid After Change Of Address	0		0		0		ns

写周期

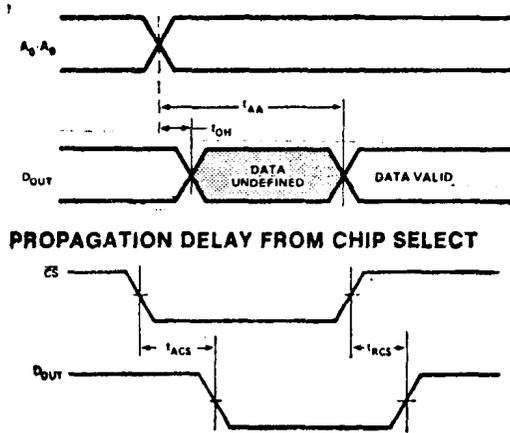
Symbol	Test	Min. Max.		Min. Max.		Min. Max.		Units
$t_{WS}$ [1]	Write Enable Time		15		20		20	ns
$t_{WR}$	Write Recovery Time	0	15	0	20	0	20	ns
$t_W$	Write Pulse Width	20		20		25		ns
$t_{WSD}$	Data Set-Up Time Prior to Write	0		0		0		ns
$t_{WHD}$	Data Hold Time After Write	0		0		0		ns
$t_{WSA}$	Address Set-Up Time	5		5		5		ns
$t_{WHA}$	Address Hold Time	0		0		0		ns
$t_{WSCS}$	Chip Select Set-Up Time	5		5		5		ns
$t_{WHCS}$	Chip Select Hold Time	0		5		5		ns

[1] 这个技术条件是由设计保证的，并不是测试产品。

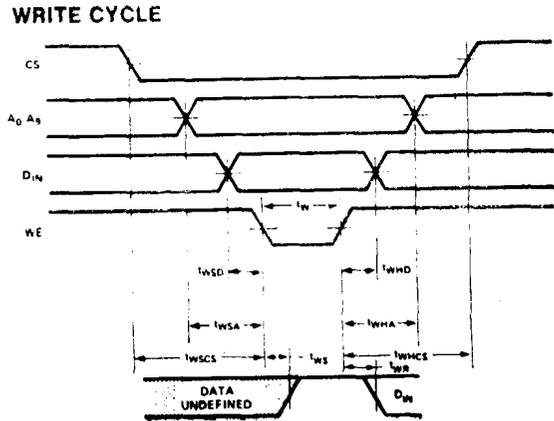
交流测试条件



读周期



写周期



以上所有测量参考点为1.5V

2125H系列交流特性  $V_{CC} = 5V \pm 5\%$ ,  $T_A = 0^\circ C$  到  $75^\circ C$

读周期

Symbol	Test	2125H-1 Limits		2125H-2 Limits		2125H-3 Limits		2125H-4 Limits		Units
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
$t_{ACS}$	Chip Select Time	15		15		20		20		ns
$t_{ZRCS}$ [1]	Chip Select to HIGH Z	20		20		20		20		ns
$t_{AA}$	Address Access Time	20		25		30		35		ns
$t_{OH}$ [1]	Previous Read Data Valid After Change of Address	0		0		0		0		ns

写周期

Symbol	Test	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Units
$t_{ZWS}$ [1]	Write Enable to HIGH Z	15		15		20		20		ns
$t_{WR}$	Write Recovery Time	0	15	0	15	0	20	0	20	ns
$t_W$	Write Pulse Width	15		20		20		25		ns
$t_{WSD}$	Data Set-Up Time Prior to Write	0		0		0		0		ns
$t_{WHD}$	Data Hold Time After Write	0		0		0		0		ns
$t_{WSA}$	Address Set-Up Time	5		5		5		5		ns
$t_{WHA}$ [1]	Address Hold Time	0		0		0		0		ns
$t_{WCS}$	Chip Select Set-Up Time	0		5		5		5		ns
$t_{WHCS}$	Chip Select Hold Time	0		0		5		5		ns

[1] 这个技术条件是由设计保证的，并不是产品测试数据。